

Coronex news



**Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,**

die Adventszeit ist da, Weihnachten und der Jahreswechsel stehen unmittelbar bevor. Jetzt werden viele Projekte abgeschlossen, aber gleichzeitig laufen die Planungen für 2014 auf Hochtouren. Dabei wollen wir Sie unterstützen.

Wir geben Ihnen mit der aktuellen Coronex News einen Rückblick auf das Jahr 2013 und zeigen Ihnen, wo wir investiert haben, um weiter ein wettbewerbsstarker Partner an Ihrer Seite zu sein. Die Productronica 2013 war für Coronex ein voller Erfolg. Wir berichten von der Messe und ziehen ein Resümee. Aus dem Einkauf stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiterin Mo Chen vor. Sie verantwortet den Bereich Materialbeschaffung in Fernost und hält den Kontakt zu asiatischen Herstellern. Wir informieren Sie über die neuesten Trends bei den Bauteilen. Denn immer komplexere Anforderungen bei abnehmender Größe der Bauteile und Leiterplatten stellen die Hersteller vor neue Voraussetzungen.

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das Jahr 2014.

Viel Spaß bei der Lektüre und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
Ihr Erhard Schäfer
Geschäftsführer Coronex Electronic GmbH

Messe

Großer Erfolg für Coronex auf der



Mit einer äußerst positiven Bilanz endete die productronica 2013 für die Coronex Electronic GmbH, die vom 12. bis zum 15. November in München stattfand.

Wolfgang Motzek und Marvin Dose waren an allen vier Messetagen als Ansprechpartner für das gesamte Dienstleistungsspektrum des Unternehmens vor Ort. Dabei beantworteten sie Anfragen von der Entwicklungsunterstützung, über die Materialbeschaffung, die Vor-Serienfertigung, Serienfertigung, Montage, kundenspezifische Prüfkonzepte bis hin zu Logistikdienstleistungen und einem umfangreichen After-Sales-Service. Aber auch der wachsende Bereich der Prozess- und Schadensanalytik, wo nicht nur die eigene Fertigung überwacht, sondern auch extern gefertigte Baugruppen der Kunden überprüft werden können, waren gefragte Gesprächsthemen.

+++ MEHR AUF SEITE 2 +++



Veranstaltung

Das FED-Diskussionsforum Krefeld zu Gast bei Coronex

„Reinigung in der Elektronikfertigung“, zu diesem Thema fanden sich die Teilnehmer des FED-Diskussionsforums Krefeld im Juni dieses Jahres bei Coronex ein.

Nach einem Firmenrundgang und einer Begrüßung durch Wolfgang Motzek, dem Leiter QS bei Coronex, war ein Vortrag von Burkhard Beermann vorgesehen, der den Amerikaner Dr. Mike Bixenman von der Firma Kyzen als Überraschungsgast mitbrachte.

+++ MEHR AUF SEITE 2 +++

Themen: Messe | Veranstaltung | Ausblick | Im Profil | Rückblick

Es gab viele interessante und informative Gespräche sowie Diskussionen am Stand. Wolfgang Motzek und Marvin Dose hatten die Gelegenheit mit einer Vielzahl potentieller Kunden und Geschäftspartner aus den unterschiedlichsten Branchen zu sprechen. Hier zeigte sich erfreulicherweise erhebliches Interesse aus den europäischen Nachbarländern sowie aus dem regionalen und überregionalen Einzugsbereich der Coronex. Ebenso stellte sich auch eine große Anzahl internationaler Lieferanten für Dienstleistungen oder Komponenten, beispielsweise aus China, Ungarn, Rumänien oder der Türkei am Stand vor.

Neben den zahlreichen Gesprächen am Stand blieb den Mitarbeitern der Coronex aber auch noch Zeit, sich mit hoch informativen Fachvorträgen (z.B. Repair und Rework, Lagerfähigkeit von Bauelementen und Baugruppen, Identifikation und Traceability oder der Bestückung und Lötung von Bauteilen der Bauform 03015) innerhalb des PCB und EMS Marketplace in der Halle B1 auseinanderzusetzen. Eine wichtige Voraussetzung, um das Leistungsspektrum der Coronex an die zukünftigen Anforderungen anpassen zu können.

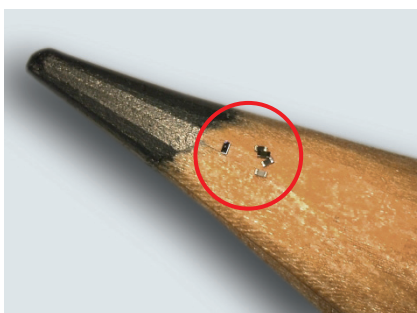


Ausblick

Elektronikfertigung in der Zukunft – Quo vadis?

Werden wir elektronische Baugruppen auch in den nächsten Jahren immer noch in klassischer SMD Weise fertigen? Lässt sich auf Folie bestücken? Bauform 01005 oder geht es noch kleiner? Wo sind die Grenzen und was erwartet uns und unsere Kunden? Wolfgang Motzek gibt uns einen kleinen Ausblick in die aktuellen Trends und Herausforderungen bei den Bauteilen.

Wer glaubt, dass die Bauteilgröße 01005 die kleinste mögliche Größe ist, den hat die Realität schon überholt. Vor einigen Monaten stellte Rohm den derzeit wohl kleinsten Chip-Widerstand der Welt vor, der mit seinen gerade einmal 0,3 x 0,15 mm – entspricht metrisch 03015 – seinem Vorgänger 01005 nochmal einige Mikrometer abnimmt.



Quelle: ASM

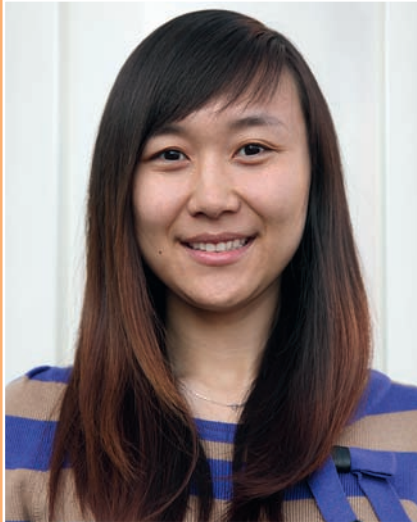
Mit dem bloßen Auge sind diese Teile kaum noch zu erkennen und machen sich auf den Musterboards von ASM und Rohm als winzige, metallisch glänzende Fläche bemerkbar. Inzwischen sind die ersten Bestückungsmaschinen in der Lage, solche Bauteile zu bestücken. Damit stehen Schablonendruck und Lötöfen vor neuen Herausforderungen. Es bleibt abzuwarten wie die Visionsysteme der Bestückungsautomaten und die AOI Systeme mit diesen Größen klarkommen werden.



Quelle: Coronex

Eine weitere Herausforderung sind die IC's im Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP), die heute schon mit 4 bis 196 Balls und Kantenlängen von gerade einmal 0,8 mm bis 6,5 mm daherkommen. Die Ballgröße liegt bei diesen Bauelementen zwischen 200 µm und 300 µm bei einer Ballhöhe von 170 µm bis 250 µm und einem Abstand von lediglich 0,30 mm bis 0,50 mm. Auch hier geht es nicht mehr ohne den Einsatz einer entsprechenden Leiterplatte in Verbindung mit einer hochwertigen Siebdruckschablone, dem geeigneten Bestückequipment und einer zuverlässigen Löttechnik.

Coronex bestückt bereits heute die Bauform WLCSP-4(DSBGA-4) und bereitet sich intensiv auf die kommenden Herausforderungen vor.



Verantwortliche für die Materialbeschaffung in Fernost, Mo Chen

Die Ingenieurin der Informations- und Kommunikationstechnik, Mo Chen, verantwortet seit Mai 2012 den Bereich Materialbeschaffung in Fernost. Davor hat sie bereits 2 Jahre in der Marketingabteilung einer Schwestergesellschaft gearbeitet. Aufgrund ihrer Muttersprache chinesisch, ist sie eine wichtige Schnittstelle zwischen Lieferanten und Kunden.

Mo Chen ergänzt das Einkaufsteam perfekt. Dank ihrer Fähigkeiten wird das Potenzial der globalen Einkaufstätigkeit und das Aufspüren von Ressourcen aus fernöstlichen Regionen bei Coronex weiter ausgeschöpft. Im Vordergrund steht für sie immer, dass die eingekaufte Ware in der geforderten Qualität, zum vereinbarten Preis und zum richtigen Zeitpunkt für die Fertigung bei Coronex zur Verfügung steht. „Ich weiß, wie wichtig es ist, dass die Rohmaterialien pünktlich bei uns eintreffen. Denn unsere Kunden sollen wie vereinbart beliefert werden. Und dafür setze ich mich täglich ein.“

Seit 2007 in Deutschland, sieht Mo Chen ihre berufliche und private Zukunft hier. „Ich fühle mich hier sehr wohl, die Arbeit macht mir Spaß und fordert mich.“

+++ WEITER VON SEITE 1 +++

Das FED-Diskussionsforum Krefeld zu Gast bei Coronex

Dr. Mike Bixenman hat den Vorsitz im Ausschuss „Cleaning and Alternatives“ des IPC und ist Mitautor des IPC-Standards IPC-CH-65B (Guidelines for Cleaning of Printed Boards and Assemblies), also ein ausgesprochener Fachmann auf dem Gebiet der Reinigung von Baugruppen. Er hielt einen Vortrag zum Thema „Stencil, Rework & Assembly Cleaning – Best Practices“ und diskutierte anschließend mit den Teilnehmern.

Das Diskussionsforum war eine sehr informative und interessante Veranstaltung. Dass die Unterhaltung auf Englisch geführt wurde, hielt die Teilnehmer nicht davon ab, engagiert in die Diskussion einzusteigen.

Rückblick

2013: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr mit Investitionen für die Zukunft

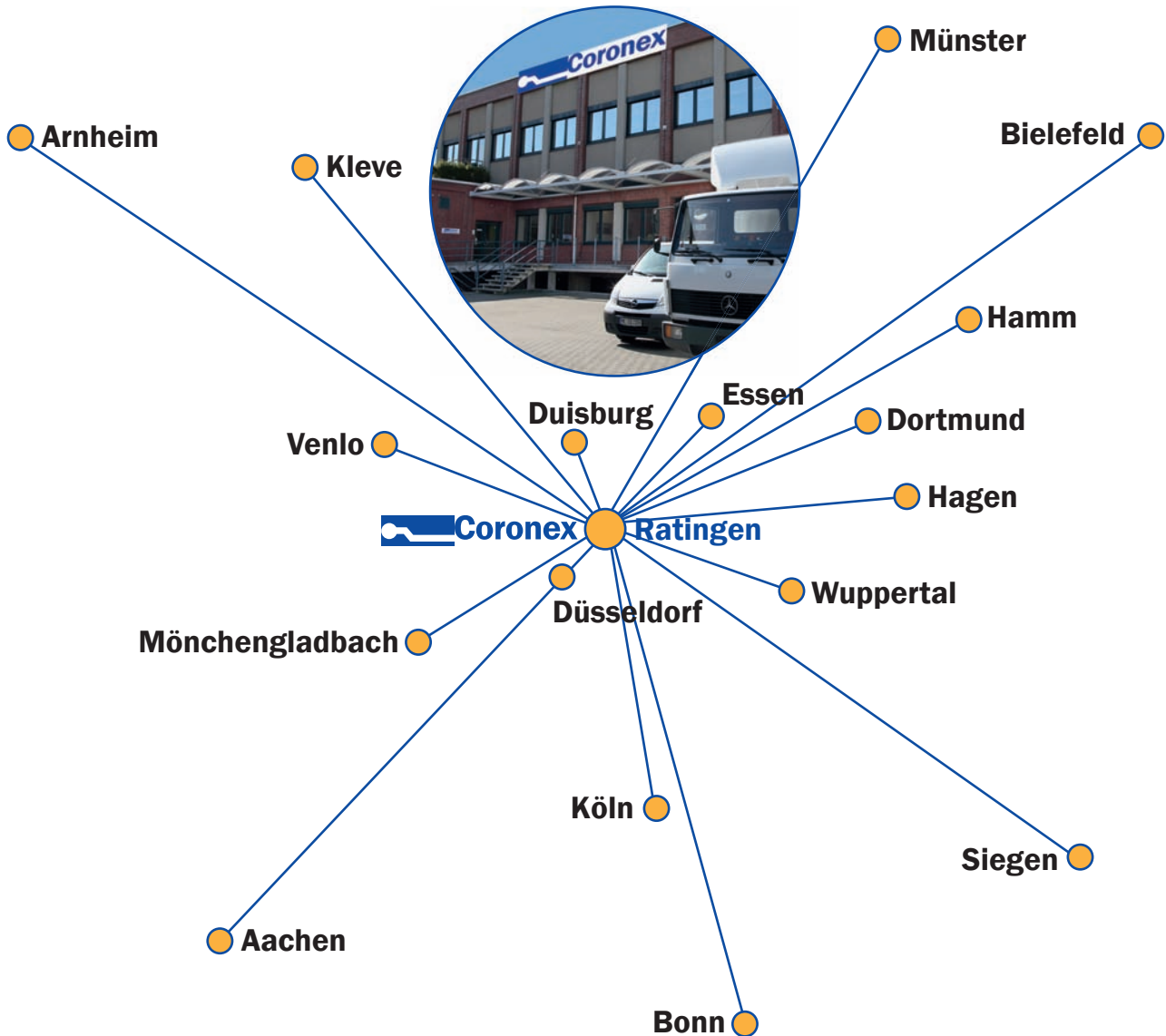
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen unmittelbar bevor. Es ist die Zeit, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Für die Coronex Electronic GmbH ist 2013 ein Jahr, das sie auf ihrem Weg bestätigt. Innovation, wettbewerbsfähige Preise, Zuverlässigkeit und die Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens bleiben zukunftsfähige Werte. Coronex hat im vergangenen Jahr das Dienstleistungsangebot in vielen Bereichen weiter optimiert. Von Ihnen wurden diese Maßnahmen durch die Vergabe neuer Aufträge, auch in neuen Technologiebereichen, belohnt.

Im Einzelnen haben wir im Logistikbereich die automatischen Läger auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das Hochregal mit 2.600 Paletten-Stellplätzen als Materialspeicher für großvolumige Teile und als Endproduktvorrat für viele Kunden, erhielt eine neue SPS-Steuerung, um die Produktions- und Kundenbelieferung weiter zu verbessern.

Für die Materialversorgung der maschinellen Bestückung mit Elektronikbauteilen wurden die Paternoster der Firma Hänel mit der neuesten Software versehen. Durch die Vernetzung aller Lagerplätze in einer Datenbank ist jetzt eine direkte und effektivere Kommissionierung nach Stücklisten möglich.

Im Wareneingang werden seit diesem Jahr alle Verpackungseinheiten von Elektronikbauteilen mit einem Kamerascanner erfasst. Der Scan wird in der Traceability-Datenbank hinterlegt. Damit ist eine Rückverfolgbarkeit nicht nur auf den Tag der Lieferung und den jeweiligen Lieferanten gewährleistet, sondern sämtliche Informationen des Herstellers bzw. Distributors, die sich auf der Verpackungseinheit befinden, sind auch noch nach Verbrauch der Verpackungseinheit für die Rückverfolgbarkeit verfügbar.

Auch 2014 wird Coronex wieder in seine Zukunftsfähigkeit investieren. Darüber werden wir in der kommenden Ausgabe der Coronex News berichten.



**Das sind wir, die Coronex Electronic GmbH –
Ihr kompetenter Partner für EMS-Dienstleistungen vor Ort.**

Coronex Electronic GmbH
Halskestraße 1
40880 Ratingen
Telefax (02102) 4284-10
www.coronex.de

Ansprechpartner:
Sebastian Seyring
Telefon (02102) 4284-86
E-Mail: s.seyring@coronex.de

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Elektronikfertigung sind wir als Zulieferer namhafter Unternehmen, unter anderem aus den Bereichen Telekommunikation, Industrieelektronik sowie Mess- und Automatisierungstechnik, tätig.

Wir bieten Ihnen mit den Schwerpunkten Materialmanagement, Produktion, Logistik und After Sales Service ein komplettes Dienstleistungsangebot auf höchstem Niveau. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind hochmotiviert und unterstützen Sie beginnend mit Ihrer Entwicklung bis zur Auslieferung des fertigen Produkts.

Wir freuen uns auf Sie!